

富满微电子集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意富满微电子集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3406号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司向特定对象发行普通股（A股）股票 11,732,499 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 76.71 元。公司共募集资金 899,999,998.29 元，扣除发行费用 9,803,521.23 元，募集资金净额 890,196,477.06 元。

截至 2021 年 12 月 7 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信会计师事务所以“信会师报字[2021]ZI10578 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 77,893.37 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,488.14 万元；于 2021 年 12 月 7 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 74,405.23 万元；本年度使用募集资金 7,455.26 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，资金利息（包括理财收入）扣除手续费后净收入 2,480.65 万元，募集资金余额为人民币 13,606.93 万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《富满微电子集团股份有限公司募集资金专项存储制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2015 年第一届第四次董事会审议通过，并经公司 2015 年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司在 2021 年 12 月 8 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2021 年 12 月 10 日与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，2021 年 12 月 17 日与中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行

查询募集资金专户资料。

根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行深圳滨海支行	79190078801800002414	489,999,998.29	5,954,897.34	活期
中信银行深圳坪山支行	8110301013100601772	200,000,000.00	13,933,865.84	活期
招商银行深圳泰然金谷支行	755928471310909	200,000,000.00	-	2022 年已注销
合计		889,999,998.29	19,888,763.18	

注：①初始存放金额中包括向特定对象发行费用（不含税）369,558.97 元。

②截止日余额中不包括购买理财产品的现金管理金额 116,180,500.00 元。

三、募集资金的使用情况

1、2024 年度募集资金使用情况

本年度详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金置换预先投入募投项目及发行费用资金情况

2024 年度，本公司不存在募集资金置换预先投入募投项目及发行费用资金情况。

3、通过承兑汇票支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换的情况

为了节约资金成本，对于募投项目的部分支出，公司与供应商协议通过承兑汇票支付，后续在募投项目实施期间定期以募集资金等额置换。2024 年度，公司使用承兑汇票支付并从募集资金账户置换的情况如下：

单位：元

募集资金投资项目	置换金额
5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目	24,613,319.79

2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，对于募投项目的部分支出，公司与供应商协议通过承兑汇票支付，而募集资金专户无法开具承兑汇票。公司经过谨慎研究，同意在实施募投项目期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目部分款项，并从募集资金专户置换等额资金。

除上述外，截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生募集资金投资项

目及募集资金使用方面变更的情形情况及对外转让或置换的情况。

4、节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，研发中心项目已达预定可使用状态。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的议案》，同意公司研发中心项目结项，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展以及“研发中心项目”尚未支付的合同尾款。

2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至本报告出具日，公司该募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成该募集资金账户的销户手续。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金的使用及披露不存在重大问题，公司将持续提升募集资金规范使用管理的水平，强化内控管理，加强员工对募集资金使用的培训管理，持续提升合规意识。

富满微电子集团股份有限公司（盖章）

二〇二五年四月十七日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：富满微电子集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		900,000,000.00			本年度投入募集资金总额		74,552,610.86			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		778,933,700.87			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目	否	500,000,000.00	500,000,000.00	66,242,854.36	409,344,728.37	81.87%	2025 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
2. 研发中心项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	8,309,756.5	169,588,972.50	84.79%	2024 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	200,000,000.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		900,000,000.00	900,000,000.00	74,552,610.86	778,933,700.87					
超募资金投向										
超募资金投向小计		-	-	-	-					
合计		900,000,000.00	900,000,000.00	74,552,610.86	778,933,700.87					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	1、2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，研发中心项目与 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目建设因市场环境变化及土地建设受地质结构、雨季、台风、安全作业要求等因素影响，项目实施完成时间延后。公司经过谨慎研究，根据公司实际经营情况，同意在不改变“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目”“研发中心项目”募集资金投资规模及用途的情况下，将“5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目”“研发中心项目”投资截止期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 6 月 30 日。 2、2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目工程建设项目部分已竣工验收，募投项目所涉生产设备仍在陆续采购中；研发中心项目相关项目内容因项目配套实施条件需与多方协调，以致实施时间延后。鉴于项目目前实施的实际情况，公司本着谨慎性原则，同意在不改变 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目、研发中心项目募集资金投资规模及用途的情况下，将研发中心项目与 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目投资截止期由 2024 年 6 月 30 日延期至 2024 年 12 月 31 日。 3、2024 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将该项目剩余募集资金									

	永久补充流动资金及部分募投项目调整募集资金投资计划进度的议案》，5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目建设因市场环境变化，公司投资进度放缓，募投项目所涉生产设备仍在陆续采购中。公司经过谨慎研究，根据公司实际经营情况，同意在不改变 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目募集资金投资规模及用途的情况下，将 5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目投资截止期由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 9 月 30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024 年 6 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，对于募投项目的部分支出，公司与供应商协议通过承兑汇票支付，而募集资金专户无法开具承兑汇票。公司经过谨慎研究，同意在实施募投项目期间，根据实际情况使用承兑汇票支付募投项目部分款项，并从募集资金专户置换等额资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 9 个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。公司独立董事、监事会及保荐人均对本事项发表了同意意见。截至 2023 年 10 月 10 日，公司已归还 1.5 亿元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金已全部归还。
用闲置募集资金进行现金管理情况	1、2022 年 1 月 4 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及并表范围内的子公司使用合计不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金购买理财产品，其中募集资金不超过人民币 2 亿元（含本数），自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数），购买原则为安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐人均对本事项发表了同意意见。 2、2022 年 4 月 15 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及并表范围内的子公司使用合计不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置募集资金及自有资金购买理财产品，其中募集资金不超过人民币 1 亿元（含本数），自有资金不超过人民币 4 亿元（含本数），购买原则为安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐人均对本事项发表了同意意见。 3、2023 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及并表范围内的子公司使用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元（含本数），自有资金不超过人民币 8 亿元（含本数），购买原则为安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐人均对本事项发表了同意意见。 4、2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买原则为安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐人均对本事项发表了同意意见。 5、2024 年 10 月 23 日，公司召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买原则为安全性高、流动性好的低风险理财产品，使用期限为自董

	事会审议通过之日起半年内有效。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司监事会及保荐人均对本事项发表了同意意见。 截至 2024 年 12 月 31 日，闲置募集资金用于购买理财产品本金为人民币 11,618.05 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“研发中心项目”实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，较好地控制了项目建设成本和费用。同时，募集资金在存放使用期间产生了一定的现金管理投资收益及利息收入。 2025 年 3 月 6 日，公司公告了《关于注销部分募集资金专户的公告》，将募集资金结余金额 33,512,425.00 元全部转入公司自有资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	针对暂时闲置的募集资金主要用于购买商业银行及证券公司的理财产品，其余未使用的募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：由于上述募投项目 2024 年度处于建设期，研发中心项目于 2024 年 12 月达到预定可使用状态，5G 射频芯片、LED 芯片及电源管理芯片生产建设项目预计 2025 年 9 月达到预定可使用状态，故 2024 年度不适用承诺效益指标。